

обертання та фоторезист розтікається тонким шаром по поверхні підкладки. Надлишки фоторезисту скидаються з підкладки та стікають по кожуху. При обертанні центрифуги з великою частотою відбувається випаровування розчинника і в'язкість фоторезисту швидко зростає.

Кварцева підкладка поміщається на предметний стол центрифуги 4 та за допомогою вакуумного захоплення та пневматичної системи (п. 16 рис. 1) фіксується. Після нанесення певної дози фоторезиста на поверхню підкладки запускається центрифугування (3000 об/хв.) Час обертання центрифуги регулюється за допомогою реле часу та складає 20-30 с.

Напівавтомат для нанесення шару фоторезиста центрифугування складається з блоків центрифуг і дозаторів, блоку управління, а також блоку подачі і прийому підкладок (вхідний/вихідний шлюз). У блоці центрифуг є електродвигун малої інерційності, частота обертання якого контролюється спеціальним електронним блоком (п. 7 рис. 1). Підкладки утримуються на столиках центрифуг вакуумним присосом, створюваним системою вакуумної відкачки (п. 16. рис.1). Блок дозаторів укріплений на задній стінці напівавтомата. Мікроконтролерний блок управління (п. 10 рис.1) забезпечує узгодження роботи всіх блоків напівавтомата. Такі напівавтомати призначені для одночасного нанесення шару фоторезиста за двома паралельними лініями, на які завантажуються стандартні касети з 25 підкладками. Після нанесення фоторезисту підкладки надходять на сушку.Етап сушки шару фоторезиста. Для остаточного видалення розчинника з шару фоторезиста його просушують.

При інфрачервоної сушці джерелом теплоти є сама напівпровідникова підкладка, поглинаюча ІЧ-випромінювання від спеціальної лампи або спіралі накаливання. Навколишнє середовище (очищений і осушений інертний газ або повітря) при цьому зберігає завдяки безперервній продувці приблизно кімнатну температуру. Якість сушіння вище, а час скорочується та становить до 5 - 10 хв.